

---

## 概 要

---

本概要旨在向閣下提供本文件所載資料的概覽。由於僅屬概要，故並無載列可能對閣下而言屬重要的所有資料，並須與本文件全文一併閱讀，以確保其完整性。閣下在決定[編纂][編纂]前，應細閱整份文件。

任何[編纂]均涉及風險。與[編纂][編纂]相關的若干特定風險載於「風險因素」。閣下在決定[編纂][編纂]前，應細閱該節。

### 概覽

#### 我們的願景

成為功率半導體器件領域的全球領導者。

#### 我們是誰

我們是領先的中國功率半導體器件提供商，專注於高性能功率半導體器件的研發、設計與銷售，尤其是我們的WLCSP產品，該產品為我們的主要產品之一，擁有先進的半導體封裝技術並以緊湊的尺寸、出色的散熱性能和抗衝擊性而著稱。我們採用獨特的「fab-lite」模式運營，戰略性地將外包標準化製造的靈活性與內部製造能力相結合，使我們得以保持供應鏈的靈活性，並實現嚴格的成本及質量控制。

我們的fab-lite模式提供了兩項核心差異化優勢，使我們有別於傳統的無晶圓廠和IDM公司：

- 與通常將所有封裝工序外包的無晶圓廠公司不同，我們擁有自主先進封裝能力（尤其是WLCSP技術），使我們能夠實現成本優化和性能提升。
- 與通常以重資產方式運營以自行完成所有晶圓製造流程的IDM公司不同，我們有選擇地保留對特定的、高附加價值的晶圓製造過程的控制，以平衡輕資產的靈活性和對關鍵晶圓製造流程的直接控制。

根據灼識諮詢的資料，我們是中國為數不多同時擁有關鍵晶圓製造流程與先進的封裝測試內部能力的功率半導體器件供應商之一。

## 概 要

### 我們的業務亮點

下圖展示了我們取得的部分亮眼成績：



附註：

- (1) 以WLCSP MOSFET產品收入計，根據灼識諮詢的資料。
- (2) 以中低壓MOSFET產品收入計，根據灼識諮詢的資料。
- (3) 根據灼識諮詢的資料。
- (4) 2025年度產能（基於封裝量）。

### 我們的多元化產品組合及應用

我們不斷豐富產品矩陣，為消費電子、汽車電子及工業應用的廣泛領域的客戶提供全面的功率半導體產品組合：

- **中低壓產品**：就功率半導體器件結構而言，我們的中低壓產品主要包括Trench MOSFET及SGT MOSFET。我們的中低壓產品被廣泛應用於消費電子、汽車電子、電機驅動、工業電源等。在中低壓產品中，我們的WLCSP產品憑藉其產品尺寸小、散熱性能高、抗衝擊性強等特點，是智能手機、平板電腦和可穿戴電子設備等鋰電池保護應用的關鍵元件。

---

## 概 要

---

- **高壓產品**：就功率半導體器件結構而言，我們的高壓產品主要包括IGBT、SJ MOSFET及Planar MOSFET。這些產品專為滿足嚴苛環境下對高耐壓、高功率密度和可靠性能的需求而設計，被廣泛應用於汽車電子、電機驅動及新能源等應用場景。

### 我們的WLCSP技術

我們關注到WLCSP技術對功率半導體器件發展及下游應用的推動作用，並戰略性佈局WLCSP技術。WLCSP是一種採用先進工藝的封裝技術，無需樹脂或引線鍵合。據灼識諮詢的資料，WLCSP具有多種優勢，包括尺寸緊湊、電氣性能優異和散熱能力出色，廣泛應用於智能座艙、智能可穿戴設備等高性能應用。根據灼識諮詢的資料，我們的WLCSP產品具備以下特點：(i)封裝厚度低至0.095mm，遠薄於傳統封裝；(ii)芯片與封裝面積比接近1:1，大於傳統封裝；及(iii)較傳統BGA/QFN封裝體積縮小約66%。

### 我們的自主製造及封裝能力

我們的珠海工廠具備晶圓製造工序和先進封裝測試能力。我們的珠海工廠通過IATF 16949汽車質量管理體系認證。配備國內領先的先進製造設備，支撐專有製造工藝和技術的商業化應用。

我們在珠海工廠進行(i)包括化鍍、晶圓探針測試、減薄及背金等在內的若干特定晶圓製造工序；及(ii)WLCSP產品的封裝測試，在滿足嚴苛質量要求與定制化需求的同時，保障高效交付。

珠海工廠還設有一個由CNAS認證的高標準可靠性測試實驗室。在該實驗室進行的測試及由該實驗室頒發的認證均獲得CNAS認可。根據灼識諮詢的資料，該實驗室為華南地區少數最先進的實驗室之一，亦為功率半導體器件公司中投資最大的實驗室之一。該實驗室主要對功率半導體器件進行長期穩定性、環境適應性及壽命測試，確保產品在複雜工況下的性能表現。

### 競爭優勢

我們相信，以下優勢將使我們能夠更好地把握未來機遇，實現持續增長：(i)我們是中國功率半導體行業先行者，綜合實力穩居行業前列；(ii)我們以WLCSP產品為核心，戰略性把握行業發展機遇；(iii)我們研發實力深厚，打造具成本競爭力的性能產品；(iv)我們以客戶價值導向為基石，長期鎖定頭部客戶；(v)我們以Fab-lite模式運營，兼具靈活供應鏈保障及核心製造環節自主可控；及(vi)我們富有遠見且行業經驗豐富的管理層，構建數智化業務並打造強大執行力團隊。

---

## 概 要

---

### 發展戰略

我們計劃採取以下戰略：(i)持續投資WLCSP等先進封裝技術的開發及應用；(ii)堅持研發驅動戰略，加碼研發投入；(iii)聚焦核心應用場景，不斷探索延展機會；(iv)透過自主研發與外部合作，提升供應鏈韌性與品質；及(v)選擇性尋求戰略合作及投資機會。

### 我們的客戶及供應商

於截至2023年及2024年12月31日止年度，以及截至2025年9月30日止九個月，我們的五大客戶於各年度／期間合計產生的收入分別為人民幣280.4百萬元、人民幣335.6百萬元和人民幣352.9百萬元，分別佔我們總收入的48.7%、53.8%和57.4%。此外，於截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，來自最大客戶的收入於各年度／期間分別佔總收入的13.8%、16.6%和22.6%。詳情請參閱「業務－我們的客戶」。

於截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，我們向五大供應商於各年度／期間的採購額分別為人民幣359.8百萬元、人民幣397.3百萬元和人民幣368.3百萬元，分別佔我們採購總額的80.5%、81.1%和72.6%。此外，於截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，我們於各年度／期間向最大供應商的採購額分別佔採購總額的29.5%、47.7%和23.0%。詳情請參閱「業務－我們的供應商」。

### 競爭

我們所在的功率半導體器件行業競爭激烈，其特點是技術發展迅速，客戶需求及偏好變化快，新產品及服務推出頻繁，新行業標準及實踐不斷湧現。

根據灼識諮詢的資料，中國功率半導體器件行業仍相對集中，前十大企業的收入佔國內市場份額的一半以上。該等企業在硅、碳化硅、氮化鎵等核心功率技術上處於領先地位，長期主導消費電子、汽車電子、工業應用、新興AI等高端應用領域，形成了穩定的供給框架。

與此同時，中國企業雖然規模相對較小，但在國內需求和下游行業增長的推動下，憑藉技術創新能力迅速擴大了市場份額。儘管大多數中國企業仍專注於中低端市場，但隨着本地化的推進以及對工藝升級及封裝技術的投資擴大，其在全球格局中的

---

## 概 要

---

影響力有望增強。縮小與海外成熟企業的技術差距仍然是首要任務，尤其是在中國推動在核心功率半導體器件元件方面提高自給自足能力和競爭力之際。有關我們面臨的競爭格局的更多信息，請參閱「行業概覽」。

### 風險因素

我們認為我們的業務涉及若干風險及不確定性，部分超出了我們的控制。我們已將該等風險及不確定性分類為：(i)與我們的業務和行業相關的風險；(ii)與在中國境內及其他司法管轄區開展業務有關的風險；及(iii)與[編纂]有關的風險。這些風險包括(其中包括)以下所列：

- 我們所處的行業競爭激烈。如果我們未能成功與其他市場參與者競爭，我們的業務、財務狀況及經營業績可能會受到重大不利影響。
- 新的科技成果或趨勢可能使我們的產品失去競爭力並遭淘汰。
- 我們的產品主要供特定行業及領域的終端客戶使用。對這些行業及領域或任何特定終端客戶造成不利影響的因素可能會對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響。
- 我們大部分的收入都來自分銷網絡。任何來自經銷商的銷售額下降或經銷商的流失都可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
- 由於各種因素，我們經營的市場規模和我們產品的需求可能不會如我們預期的那樣快速增長，這將對我們的業務、財務狀況、經營業績和前景產生重大不利影響。
- 我們一直並有意繼續在研發活動上投入大量資金，從而可能會對我們的盈利能力和經營現金流產生不利影響，並且可能不會產生我們期望達成的結果。
- 我們受到半導體行業波動的影響。
- 經銷商的行為及其可能違反分銷協議或適用法律法規的風險可能會對我們的業務造成不利影響。
- 我們可能無法完全控制我們產品的質量。
- 我們依賴有限數量的第三方晶圓代工合作夥伴來製造我們的產品。

## 概 要

### 歷史財務資料概要

綜合財務資料概要應與本文件附錄一會計師報告所載綜合財務資料連同相關附註及本文件「財務資料」所載內容一併閱讀。

### 綜合損益表概要

下表載列截至所示年度／期間我們綜合損益表的主要項目：

	截至12月31日止年度				截至9月30日止九個月			
	2023年		2024年		2024年		2025年	
	人民幣千元	(%)	人民幣千元	(%)	人民幣千元 (未經審核)	(%)	人民幣千元 (未經審核)	(%)
收入 .....	575,477	100.0	624,259	100.0	418,876	100.0	614,912	100.0
銷售成本.....	(488,075)	(84.8)	(515,370)	(82.6)	(352,470)	(84.1)	(468,736)	(76.2)
毛利 .....	87,402	15.2	108,889	17.4	66,406	15.9	146,176	23.8
年度／期間利潤.....	13,977	2.4	19,353	3.1	4,214	1.0	40,254	6.5

### 按產品劃分的收入

下表載列我們於所示期間按產品劃分的收入，以絕對金額及佔總收入的百分比呈列：

	截至12月31日止年度				截至9月30日止九個月			
	2023年		2024年		2024年		2025年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元 (未經審核)	%	人民幣千元 (未經審核)	%
中低壓功率								
半導體器件 .....	536,089	93.1	561,565	90.0	378,802	90.4	574,368	93.4
WLCSP產品 .....	161,345	28.0	243,872	39.1	166,426	39.7	258,179	42.0
非WLCSP產品 .....	374,744	65.1	317,693	50.9	212,376	50.7	316,189	51.4
高壓功率半導體器件 .....	6,801	1.2	10,076	1.6	5,450	1.3	11,885	1.9
其他 <sup>(1)</sup> .....	32,587	5.7	52,618	8.4	34,624	8.3	28,659	4.7
總計 .....	<u>575,477</u>	<u>100.0</u>	<u>624,259</u>	<u>100.0</u>	<u>418,876</u>	<u>100.0</u>	<u>614,912</u>	<u>100.0</u>

附註：

(1) 其他主要包括銷售晶圓及提供加工服務及可靠性測試服務的收入。

## 概 要

### 按產品劃分的毛利及毛利率

下表載列我們在所示期間按產品劃分的毛利及毛利率明細：

	截至12月31日止年度				截至9月30日止九個月			
	2023年		2024年		2024年		2025年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
	人民幣千元	(%)	人民幣千元	(%)	人民幣千元	(%)	人民幣千元	(%)
					(未經審核)		(未經審核)	
<b>產品銷售</b>								
<b>中低壓功率</b>								
半導體器件 .....	113,011	21.1	122,460	21.8	81,664	21.6	142,854	24.9
WLCSP產品 .....	32,855	20.4	45,243	18.6	30,367	18.2	82,814	32.1
非WLCSP產品 .....	80,156	21.4	77,217	24.3	51,297	24.2	60,040	19.0
<b>高壓功率</b>								
半導體器件 .....	538	7.9	(2,354)	(23.4)	(84)	(1.5)	(5,469)	(46.0)
其他 <sup>(1)</sup> .....	4,833	14.8	10,990	20.9	6,604	19.1	8,414	29.4
小計 .....	118,382	20.6	131,096	21.0	88,184	21.1	145,799	23.7
存貨撇減 .....	30,980		22,207		21,778		(377)	
總計 .....	<b>87,402</b>	<b>15.2</b>	<b>108,889</b>	<b>17.4</b>	<b>66,406</b>	<b>15.9</b>	<b>146,176</b>	<b>23.8</b>

附註：

(1) 其他主要包括銷售晶圓及提供加工服務及可靠性測試服務。

### 選定財務狀況表項目概要

下表載列截至所示日期我們綜合財務狀況表中的部分資料：

	截至12月31日		截至9月30日
	2023年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
			(未經審核)
非流動資產總值 .....	203,299	284,178	317,730
流動資產總值 .....	542,163	526,942	540,349
資產總值 .....	<b>745,462</b>	<b>811,120</b>	<b>858,079</b>

## 概 要

	截至12月31日		截至9月30日
	2023年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元 (未經審核)
非流動負債總額.....	30,804	79,701	69,296
流動負債總額.....	113,932	111,078	123,813
<b>負債總額.....</b>	<b>144,736</b>	<b>190,779</b>	<b>193,109</b>
<b>資產淨值.....</b>	<b>600,726</b>	<b>620,341</b>	<b>664,970</b>

於往績記錄期間，我們的資產淨值自2023年至2024年及2025年9月30日呈現增加趨勢，主要由於自2023年以來的年度或期間錄得利潤。

### 綜合現金流量表概要

下表載列於所示期間的選定現金流量表數據：

	截至12月31日止年度		截至9月30日止九個月	
	2023年	2024年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)
經營活動所得／(所用)				
現金淨額.....	31,165	58,154	(1,600)	48,115
投資活動所用				
現金淨額.....	(50,323)	(150,579)	(117,641)	(59,294)
融資活動所得／(所用)				
現金淨額.....	29,975	52,639	30,457	(22,313)
<b>現金及現金等價物增加／(減少)淨額.....</b>	<b>10,817</b>	<b>(39,786)</b>	<b>(88,784)</b>	<b>(33,492)</b>
年／期初現金及				
現金等價物.....	201,548	212,170	212,170	172,476
匯率變動的影響淨額.....	(195)	92	(677)	(680)
<b>年／期末現金及現金</b>				
<b>    等價物.....</b>	<b>212,170</b>	<b>172,476</b>	<b>122,709</b>	<b>138,304</b>

## 概 要

### 主要財務指標

下表載列我們截至所示日期或所示期間的主要財務比率：

	截至12月31日或 截至12月31日止年度		截至9月30日或 截至9月30日 止九個月
	2023年	2024年	2025年
毛利率 . . . . .	15.2%	17.4%	23.8%
淨利潤率 . . . . .	2.4%	3.1%	6.5%
權益回報率 <sup>(1)</sup> . . . . .	2.3%	3.2%	6.3%
總資產回報率 <sup>(2)</sup> . . . . .	2.0%	2.5%	4.8%
流動比率 <sup>(3)</sup> . . . . .	4.8	4.7	4.4

附註：

- (1) 權益回報率乃按各年度的淨利潤除以權益總額的期初及期末結餘的算術平均值再乘以100%計算。
- (2) 總資產回報率乃按各年度淨利潤除以總資產的期初及期末結餘的算術平均值再乘以100%計算。
- (3) 流動比率乃按截至所示日期的流動資產除以流動負債計算。

### 法律訴訟及不合規

我們可能不時捲入我們業務的日常經營引起的糾紛或法律訴訟。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無涉及任何我們認為會對我們的業務、經營業績、財務狀況或聲譽及合規情況產生重大不利影響的實際或待決法律、仲裁或行政訴訟（包括任何破產或接管程序）。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未曾涉及任何導致罰款、強制行動或其他處罰的重大不合規事件，而該等事件可能個別或共同對我們的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響。有關我們需遵守的法律法規的詳情，請參閱「監管概覽」。

---

## 概 要

---

### 我們的控股股東

緊隨[編纂]完成後及假設[編纂]未獲行使，李先生連同其控制的實體（即舟山拓緯及舟山集成）將共同於[編纂]股股份（相當於我們全部已發行股份及本公司投票權的約[編纂]%）中擁有權益並控制該等股份。因此，[編纂]後，李先生、舟山拓緯及舟山集成將構成一組控股股東。詳情請參閱「與控股股東的關係」。

### [編纂]前投資

我們從[編纂]前投資者獲得股權融資，以支持我們不斷擴展的業務營運。我們多樣化的[編纂]前投資者群體包括（其中包括）OPPO廣東、英特爾亞太、元禾璞華及寧德新能源，截至最後實際可行日期分別持有我們全部已發行及發行在外股份的約5.05%、3.90%、2.77%及1.33%。截至最後實際可行日期，[編纂]前投資的全部所得款項均已動用。詳情請參閱「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資－有關我們的[編纂]前投資者的資料」。

[編纂]

---

## 概 要

---

### 股息

在本公司股東或董事（如適用）批准派發股息期間，向股東分派股息確認為負債。於往績記錄期間，本公司概無派付或宣派任何股息。截至最後實際可行日期，我們並無正式股息政策或預先釐定的派息率。

於[編纂]完成後，我們可以現金或組織章程細則准許的其他方式分派股息。任何建議分派的股息應由董事會制定，並須經股東批准。日後宣派或支付任何股息的決定，以及任何股息金額，將取決於多項因素，包括我們的盈利及財務狀況、營運規定、資本需求、業務前景、宣派及派付股息上的法定、監管及合約限制，以及董事可能認為屬重要的任何其他因素。

### 未來計劃及[編纂]用途

假設[編纂]為每股股份[編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍中位數），經扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]及其他估計開支後，並假設[編纂]未獲行使，我們估計將收取[編纂][編纂]淨額約[編纂]港元（相等於約人民幣[編纂]元）。根據我們的策略，我們擬將[編纂][編纂]按下述金額用於下述用途：

- [編纂]淨額約[編纂]%或約[編纂]港元，預計將用於新建一個生產基地。
- [編纂]淨額約[編纂]%或約[編纂]港元，預計用於加強研發能力及撥資關鍵研發項目。
- [編纂]淨額約[編纂]%或約[編纂]港元，預計用於審慎進行戰略投資及收購。
- [編纂]淨額約[編纂]%或約[編纂]港元，預計用於營運資金及一般企業用途。

進一步詳情請參閱「未來計劃及[編纂]用途」。

---

## 概 要

---

### [編纂]開支

[編纂]開支指[編纂]產生的專業費用、[編纂]及其他費用（例如酌情激勵費）。我們估計[編纂]開支將約為人民幣[編纂]元（或[編纂]港元，佔[編纂][編纂]總額[編纂]%）（假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的中位數）且並無行使[編纂]），其中(i)約人民幣[編纂]元與發行[編纂]直接相關，其後將於建議[編纂]完成後自權益中扣除；(ii)人民幣[編纂]百萬元已於截至2025年9月30日止九個月的合併損益表支銷；及(iii)約人民幣[編纂]元預期將於2025年9月30日後的合併損益表支銷。

### 近期發展及無重大不利變動

於2025年10月，我們的附屬公司威兆集成電路（舟山）有限公司（「威兆舟山」）與浙江省舟山市自然資源和規劃局訂立土地使用權出讓合同。根據該合同，威兆舟山同意收購位於舟山市普陀區的一塊國有建設用地的土地使用權，代價總額約為人民幣51.7百萬元。詳情請參閱「業務－物業－自有物業」。

董事確認，自2025年9月30日（即我們最近一期綜合財務報表的結束日期）直至本文件日期，我們的財務或貿易狀況或前景未發生重大不利變動，且自2025年9月30日以來並無任何事件會對本文件附錄一會計師報告所載資料產生重大影響。